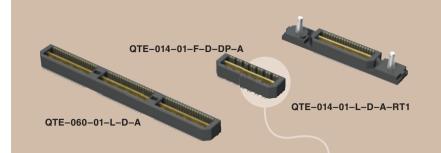


(0,80mm) .0315"

QTE 系列



标准型

# 高速接地插头

## 技术规格

如需了解完整技术规格以及所建 议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?QTE

绝缘体材料:

在 50µ" (1,27µm) 的镍上 镀金或锡 **额定电流:** 

触点: 95°C 时为 1.3A 接地板: 95°C 时为 10.1A 工作温度范围:

-55°C 至 +125°C 额定电压: 225 VAC 与 QSE 配接 和 5mm 堆叠高度

最大次数: 100 拔出力 (-RT1 选项): -RT1 选择增加 拔出力多达 50% 符合 RoHS 规范要求:

加工: 可无铅焊接:是 SMT引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大 (020-060) (0,15mm) \_006" 最大 (080) 电路板相叠:

有关每块电路板需要两个连接器 或 4 列或更多列的应用, 请联系 ipg@samtec.com

## 特殊应用选项

- 14mm、15mm、22mm 和 30mm 堆叠高度 (小心:有些自动放置/ 插入机械可能有元件高度 限制。请参考机械技术规
- 30µ" (0,76µm) 金(为数据 速率线缆配接应用指定 -H 电镀。)
- 边缘封装
- 每排 100 个位置
- 导柱、拧紧螺丝和摩擦锁 请致电 Samtec。

-C 电镀通过 10 年 MFG 测试

注:有些长度、式样和选项为 非标准型,不可退换。



5mm 堆叠高度 类型 在 3dB 插入损耗的额定值 单端信号 -D 9 GHz / 18 Gbps 差分对信号 \_D 8 GHz / 16 Gbps 差分对信号 -DP 8.5 GHz / 17 Gbps

EXTENDED LIFE PRODUCT

50µ" 镀金的 10 年腐蚀和老化试验 有关与 QSE 配接的最大插拔次数,请致电 Samtec

如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?QTE 或联系 sig@samtec.com

每排引脚数

对数

堆叠高度 从 5mm 到 25mm 8 8 8 8 极性标记

·体式金属

电源或接地板

板间隔支架。 参见 SO 系列。

- SAMTEC
- E.L.P.™ 镀金选项 (-C)
- 固定引脚选项

XAUI PCI Express® SATA

MGT (Rocket 1/0) Infiniband 登录 www.samtec.com/appnote

下载应用注释 通过 samtec.com 联系 SIG 了解有关协议的问题

类型 电镀选项 其他选项

8

8

8

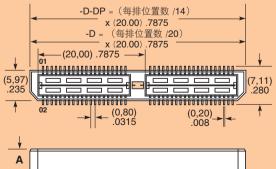
8

8

8

020, -040, -060, -080 (每列总共 40 个引脚 = -D)

014, -028, -042, -056 (每列 14 对 = -D-DP)



(3,30).130 (0.76).030 062

(1,57)(0,89) .062 .035 -01 -RT1 从图表 在信号引脚和接地板 \_镀金膜 焊尾镀雾锡

= 在信号引脚和 接地板上镀

10μ" (0,25μm) 的金, 焊尾镀雾锡

\_C\*

= 可选电镀 在触点区域的信号引 脚上镀 150µ" (3,81µm) 镍,

之上镀最少 50μ" (1,27μm) 的金, 在触点区域的接地板 上镀

50μ" (1,27μm) 镍 之上镀最少

10µ" (0,25µm) 金 在所有焊尾上镀最少 50µ" (1,27µm) 镍

.025

-D = 単端 -D-DP

= 差分对 (仅限 -01)

QTE 引线 式样	A	与 <b>QSE</b> 的 高度*
-01	(4,27) .168	(5,00) .197
-02	(7,26) .286	(8,00) .315
-03	(10,27) .404	(11,00) .433
-04	(15,25) .600	(16,00) .630
-05	(18,26) .718	(19,00) .748
-07	(24,24) .954	(25,00) .984
*加工条件将 影响配接高度。		

= (7,00mm) .**275**" 直径的聚 酰亚胺膜取放<u>垫</u>

- **TR** = 卷带封装 (56 和 80 个位 置不提供)

-RT1

= 固定选择 (适用于 -01 引线式样) (56 和 80 个位 置或 **-L** (卡锁) 选项时不

提供)

- 锁紧选项 (42, 56, 60 和 80 个位置或 –RT1 选项不提供)

因为技术的发展,所有设计、技术规范和组件如有更改,恕不另行通知。